

Stereo-seq 芯片载体 保存操作指南

版本号:C1

文档编号:STOG00002

收到后

Stereo-seq 芯片载体装于真空密封的铝袋中, 冷链运输。

若发现冷链箱温度异常, 可要求物流方现场打印温度实时监控记录表; 签收后也可联系当地科研合作代表, 以查询相关记录。

请及时确认铝袋是否完好并处于真空密封状态, 随后立即将未开封的芯片载体转移至4°C的条件下储存。若转移时间较长, 建议使用控温容器运输。

未开封的情况下, 产品可在4°C保存至标签上的有效期。

打开后

将未使用的Stereo-seq 芯片载体放入玻片盒, 随后放回原装铝袋中。往铝袋中放入干燥剂, 尽量挤出袋内空气并重新密封。

再次确认铝袋是否完好并处于密封状态, 随后立即将铝袋储存在4°C。未真空密封的芯片不可放置超过两周, 开封后请尽快使用。

请您拆开铝袋后检查以下事项:

- 芯片种类与包装描述不符
- 芯片数量与产品规格不符
- 芯片正面有肉眼可见划痕
- 芯片和玻片载体贴合松动
- 组装手持载具时, 芯片位置与垫圈孔位无法匹配

如果您发现产品存在上述问题, 请及时将情况反馈给科研合作代表或技术人员。

更多产品指南

请前往查看或下载:

www.stomics.tech/resources/Documents



Step 1:在页面右侧勾选栏中点击想要查看的指南类型。

Step 2:点击“在线浏览”可进入预览页面,点击“下载”可进入下载页面。

联系我们

网址:www.stomics.tech/

邮箱:services@stomics.tech